

LPKF auf der productronica 2023

Leistungsfähige Lasertechnologie für die Elektronikindustrie

Ansprechpartner:

Jonathan Haig
jonathan.haig@lpkf.com
Tel. +49 (0)5131 7095-0
Fax +49 (0)5131 7095-90

LPKF Laser & Electronics SE

Osteriede 7
D-30827 Garbsen
www.lpkf.com

Vorstand

Klaus Fiedler
Christian Witt

Aktie

Prime Standard
ISIN 0006450000

Abdruck frei,
Beleg erbeten

Produkt- und Markennamen sind Marken von LPKF Laser & Electronics SE, die u. a. beim US-Patent- und Markenamt USPTO registriert sind: LPKF® und das Firmenlogo, # 2,385,062 und # 2,374,780; Solarquipment®, # 3,494,986; ProConduct®, # 3,219,251; Allegro®, # 3,514,950.

Die productronica von 14. bis 17. November in München ist die Leitmesse für die Elektronikentwicklung und -fertigung. LPKF präsentiert sich dort mit Systemen zum PCB-Prototyping, zum PCB-Trennen, zur Stencilherstellung und zum Laser-Kunststoffschweißen mit dem neuen, modernen Messestand in Halle B2, Stand B2.303. In der gleichen Halle findet die diesjährige Semicon Europa statt. LPKF präsentiert dort am Stand B2.154 innovative Glasbearbeitung mit den Vitrion-Lasermaschinen zum Beispiel zur Herstellung von Glasinterposern oder in der Display-Technologie.

Der Termin steht fest im Kalender. LPKF-Marketingchef Jonathan Haig freut sich auch in diesem Jahr auf die productronica: „Hier zeigen wir unter dem Motto ‚Innovating Electronics Together‘, wo LPKF-Hightech zu neuen, modernen Produkten und Produktionsverfahren führt“. Der Messestand nimmt diese Idee auf und wird erstmals in einem neuen Look & Feel präsentiert. Er ist interaktiver als zuvor und bietet mit seiner offenen Struktur Raum für direkte Gespräche.

Beim chemielosen PCB-Prototyping setzt LPKF die Maßstäbe. Auf der productronica werden der ProtoMat S104 und der ProtoLaser U4 ausgestellt. Der ProtoMat S104 ist das mechanische Spitzensystem der Fräsbohrplotter. Er strukturiert, bohrt und separiert ein- oder doppelseitige PCB mit einer Präzision, die problemlos Anforderungen der RF-Technologie erfüllt. Der ProtoLaser U4 hingegen nutzt einen UV-Laser als Werkzeug. Auch er kann PCBs

strukturieren und schneiden, spielt seine Fähigkeiten aber auch bei ungewöhnlichen und empfindlichen Materialien aus.

Für den Druck von Lotpasten sind Stencils unverzichtbar. Spezielle Produktionsverfahren stellen deren Qualität sicher. Der LPKF StencilLaser G6080 ist das Spitzensystem zum Schneiden dieser Folien, eignet sich aber auch hervorragend für die Herstellung von filigranen Mikroschneidteilen. Er wird in der 3. Generation präsentiert: Erstmals beschleunigt ein scannerbasierter Laserprozess den Schneidvorgang bei gleichzeitig steigender Qualität. Die ebenfalls brandneue Systemsoftware LPKF StencilPro erleichtert die Einrichtung der Prozessdaten aus den CAD-Files der Entwicklung.

Um einzelne Platinen aus größeren Nutzen zu trennen, sind Lasersystemen heute das Mittel der Wahl. Minimale Schneidkanäle, beliebige Konturen, präzise und saubere Schnittkanten – keine andere Technologie kann dabei mit der Lasertechnologie mithalten.

Der auf der productronica vorgestellte CuttingMaster Cx verfügt erstmals über einen „Cobot“, einen Roboterarm, der die Bestückung und Entladung im System übernimmt – eine preisgünstige Automatisierungslösung mit geringem Platzbedarf.

Wenn Elektronikkomponenten sicher und optisch ansprechend in Gehäuse platziert werden sollen, kommt das Laser-Kunststoffschweißen zum Einsatz. Das kompakte InlineWeld-6000-System integriert sich in Produktionsstraßen und kann problemlos in vorhandene MES-Lösungen eingebunden werden.

Neben den ausgestellten Systemen sind auch Spezialisten für die Anwendungsbereiche mit aussagekräftigen Exponaten am Stand – eine gute Gelegenheit für Besucher, eigene Applikationsvorstellungen direkt zu besprechen. Wer Interesse an hochwertigen Produktionsdienstleistungen hat, wird ebenfalls fündig. Unter der Marke

LaserMicronics werden anspruchsvolle Produkte mit LPKF-Technologie im Auftrag hergestellt. Auch LaserMicronics-Vertreter freuen sich auf Anfragen.